

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號： 1347

新聞稿

華虹半導體二零一六年第一季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2016年5月11日 — 全球領先的200mm純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零一六年三月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零一六年第一季度主要財務指標 (未經審核)

- 銷售收入 1.644 億美元，環比上升 18.0%，同比略下降 1.0%。
- 毛利率 29.2%，環比下降 0.3 個百分點，同比下降 1.3 個百分點。
- 期內溢利 2,180 萬美元，環比增長 4.5%，同比下降 11.9%。
- 每股盈利 0.02 美元，環比、同比均持平。

二零一六年第二季度指引

- 我們預計銷售收入環比增長 5%~7%。
- 我們預計毛利率在 29%至 31%之間。

本公司總裁兼執行董事王煜先生，對業績評論說：

“本季度我們的業績表現強勁，已經從上季度暫時的下降中完全恢復。銷售收入達到 1.644 億美元，環比上升 18%。顯然，我們所有業務均明顯回升，尤其是智能卡、微控制器、超級結 MOSFET、電源管理芯片、模擬、邏輯及射頻產品。強勁的客戶需求提高了銷售額和產能利用率。儘管折舊費用有所增加，本季度毛利率仍達到 29.2%。”

“對全球，尤其是中國的機遇，我們仍感振奮。下面是我想與大家分享的一些情況。最近，我們一家重要的中國銀行卡芯片客戶已獲得一個國際組織的全面認證，並已準備放量生產。華虹半導體是中國銀行卡芯片業務的領導者。中低端智能手機的需求穩定，作為結果，對於觸屏、光學運動穩定器、擴音器、充電器、指紋感測器等微控制器晶片的需求也很充足。隨著中國越來越環保，對電動車的需求也大幅上升。中國政府近來一直為電動車充電設備的設置提供補貼。因此，我們預期我們的超級結和 IGBT 產品未來的需求會很大。”

“正如我們已經公告的，”王煜先生繼續說道，“我們的 90 納米技術已經完全驗證合格。許多應用正在升級到這一新的技術節點上，並將於今年下半年開始量產，從而進一步優化產品組合。”

王煜先生最後總結道，“華虹半導體在充滿活力的全球半導體行業中處於有利地位，並將為客戶帶來巨大收益。

電話會議公告

日期：二零一六年五月十二日

時間：上海時間下午四時

廣播：該電話會議將於下述網站進行語音及幻燈片直播：

http://www.huahonggrace.com/html/investor_webcast.php 或

https://engage.vevent.com/rt/huahongsemiconductor~2016_q1_earnings_call

電話詳細：

中國 +86 800 870 0531/+86 400 624 0406

香港 +852 3018 6768

臺灣 +886 2 7703 1751

美國 +1 347 549 4095/+1 844 760 0767

新加坡 +65 6713 5521

電話會議登入名： 89963105

密碼： Hua Hong

該電話會議廣播的錄音版本，連同本新聞稿的電子檔，都將在本新聞稿廣播後 6 個月內刊登於華虹半導體的網站上。

關於華虹半導體

本公司是一家全球領先的 200mm 純晶圓代工廠。本公司在上海設有三家晶圓廠，主要專注製造特種應用的晶圓半導體。本公司生產的半導體被廣泛應用於不同市場各類產品，主要包括電子消費品、通訊、計算機、工業及汽車等。本公司採用自身的專有工藝及技術，為多元化客戶製造符合其設計規格的半導體，本公司亦提供設計支援服務，以便及時完成在工藝的性能、成本及製成品率各方面均達致最優的複雜設計。

如需查詢詳細資訊，請登陸華虹半導體網站 <http://www.huahonggrace.com/>

經營業績概要
(以千美元為單位，每股盈利和營運數據除外)

	二零一六年 第一季度 (未經審核)	二零一五年 第四季度 (未經審核)	二零一五年 第一季度 (未經審核)	環比	同比
銷售收入	164,426	139,402	166,088	18.0 %	(1.0) %
銷售成本	(116,397)	(98,290)	(115,364)	18.4 %	0.9 %
毛利	48,029	41,112	50,724	16.8 %	(5.3) %
毛利率	29.2 %	29.5 %	30.5 %	(0.3)	(1.3)
經營開支	(23,233)	(29,968)	(23,793)	(22.5) %	(2.4) %
其他收入淨額	1,943	14,244	5,630	(86.4) %	(65.5) %
稅前溢利	26,739	25,388	32,561	5.3 %	(17.9) %
所得稅開支	(4,929)	(4,522)	(7,795)	9.0 %	(36.8) %
期內溢利	21,810	20,866	24,766	4.5 %	(11.9) %
淨利潤率	13.3 %	15.0 %	14.9 %	(1.7)	(1.6)
每股盈利					
基本	0.02	0.02	0.02	-	-
攤薄	0.02	0.02	0.02	-	-
付運晶圓(仟片)	391	332	351	17.8 %	11.4 %
產能利用率 ¹	94.7 %	80.3 %	96.1 %	14.4	(1.4)
淨資產收益率 ²	1.4 %	1.4 %	1.7 %	-	(0.3)

- 銷售收入 1.644 億美元，環比上升 18.0%，同比下降 1.0%。
- 銷售成本 1.164 億美元，環比上升 18.4%，主要由於晶圓銷售量增加所致。
- 毛利率 29.2%，環比下降 0.3 個百分點，主要由於本季度折舊費用增加以及上季度存貨減值準備轉回的影響所致。
- 經營開支 2,320 萬美元，環比下降 22.5%，主要由於上季度計提年終獎金所致。
- 其他收入淨額 190 萬美元，環比下降 86.4%，主要由於本季度發生匯兌損失以及獲得的補助較少所致。
- 所得稅開支 490 萬美元，環比上升 9.0%，主要由於應稅利潤上升所致。
- 期內溢利 2,180 萬美元，環比上升 4.5%。
- 淨利潤率 13.3%，環比下降 1.7 個百分點。

¹ 產能利用率按平均月產量除以總估計月產能計算。

² 期內溢利 / 加權平均淨資產。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零一六年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一六年 第一季度 % (未經審核)	二零一五年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一五年 第四季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
晶圓	161,030	97.9%	135,648	97.3%	25,382	18.7 %
其他	3,396	2.1%	3,754	2.7%	(358)	(9.5)%
銷售收入總額	164,426	100.0%	139,402	100.0%	25,024	18.0 %

- 本季度 97.9%的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零一六年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一六年 第一季度 % (未經審核)	二零一五年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一五年 第四季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
中國 ³	82,032	49.9%	75,166	53.9%	6,866	9.1 %
美國	38,340	23.3%	27,415	19.7%	10,925	39.9 %
亞洲 ⁴	18,310	11.1%	11,555	8.2%	6,755	58.5 %
歐洲	15,791	9.6%	15,011	10.8%	780	5.2 %
日本 ⁵	9,953	6.1%	10,255	7.4%	(302)	(2.9)%
銷售收入總額	164,426	100.0%	139,402	100.0%	25,024	18.0 %

- 本季度來自中國的銷售收入 8,200 萬美元，占銷售收入總額的 49.9%，環比增長 9.1%，主要得益於 LED 照明、微控制器、智能卡及射頻產品的需求增加。
- 本季度來自美國的銷售收入 3,830 萬美元，環比增長 39.9%，主要得益於分立器及微控制器產品的需求增加。
- 本季度來自亞洲的銷售收入 1,830 萬美元，環比增長 58.5%，主要得益於微控制器、邏輯及模擬產品的需求增加。
- 本季度來自歐洲和日本的銷售收入環比持平。

³包括香港。

⁴不包括中國及日本。

⁵包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一名主要日本客戶。

銷售收入分析

按技術平臺劃分的 銷售收入	二零一六年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一六年 第一季度 % (未經審核)	二零一五年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一五年 第四季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
嵌入式非易失性存儲器	65,863	40.0%	58,870	42.2%	6,993	11.9 %
分立器	42,837	26.1%	37,886	27.2%	4,951	13.1 %
模擬與電源管理	26,402	16.1%	21,166	15.2%	5,236	24.7 %
邏輯及射頻	21,907	13.3%	14,217	10.2%	7,690	54.1 %
獨立非易失性存儲器	6,928	4.2%	6,724	4.8%	204	3.0 %
其他	489	0.3%	539	0.4%	(50)	(9.3)%
銷售收入總額	164,426	100.0%	139,402	100.0%	25,024	18.0 %

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 6,590 萬美元，環比增長 11.9%，主要得益于微控制器產品的需求增加。
- 本季度分立器銷售收入 4,280 萬美元，環比增長 13.1%，主要得益于超級結和常規 MOSFET 產品的需求增加。
- 本季度模擬與電源管理產品銷售收入 2,640 萬美元，環比增長 24.7%，主要得益于 LED 照明、電源管理芯片和模擬產品的需求增加。
- 本季度邏輯及射頻產品銷售收入 2,190 萬美元，環比增長 54.1%，主要得益于美國和臺灣地區的邏輯及射頻產品的客戶需求增加。
- 本季度獨立非易失性存儲器及其他產品銷售收入環比持平。

銷售收入分析

按工藝技術節點 劃分的銷售收入	二零一六年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一六年 第一季度 % (未經審核)	二零一五年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一五年 第四季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
0.13μm 及以下	57,644	35.1%	50,269	36.1%	7,375	14.7 %
0.15μm & 0.18μm	27,453	16.7%	22,149	15.9%	5,304	23.9 %
0.25μm	4,352	2.6%	4,153	3.0%	199	4.8 %
0.35μm 及以上	74,977	45.6%	62,831	45.0%	12,146	19.3 %
銷售收入總額	164,426	100.0%	139,402	100.0%	25,024	18.0 %

- 本季度來自 0.13μm 及以下工藝技術節點產品的銷售收入 5,760 萬美元，環比增長 14.7%，主要得益於微控制器及邏輯產品的需求增加。
- 本季度來自 0.15μm 及 0.18μm 工藝技術節點產品的銷售收入 2,750 萬美元，環比增長 23.9%，主要得益於邏輯及射頻產品的需求增加。
- 本季度來自 0.35μm 及以上工藝技術節點產品的銷售收入 7,500 萬美元，環比增長 19.3%，主要得益於 LED 照明及分立器產品的需求增加。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零一六年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一六年 第一季度 % (未經審核)	二零一五年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一五年 第四季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
電子消費品	99,505	60.5%	78,918	56.6%	20,587	26.1 %
通訊	31,549	19.2%	30,230	21.7%	1,319	4.4 %
工業及汽車	19,080	11.6%	19,569	14.0%	(489)	(2.5)%
計算機	14,292	8.7%	10,685	7.7%	3,607	33.8 %
銷售收入總額	164,426	100.0%	139,402	100.0%	25,024	18.0 %

- 電子消費品及通訊仍是我們的第一及第二大終端市場分佈，本季度合計貢獻 79.7%的銷售收入，上一季度為 78.3%。
- 本季度電子消費品銷售收入 9,950 萬美元，環比增長 26.1%，主要得益於微控制器、智能卡、電源管理芯片及邏輯產品的需求增加。
- 本季度計算機產品銷售收入 1,430 萬美元，環比增長 33.8%，主要得益於邏輯產品、分立器及微控制器的需求增加。

產能⁶及產能利用率

晶圓廠(仟片晶圓每月)	二零一六年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零一五年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一五年 第一季度 仟美元 (未經審核)
1 號晶圓廠	56	56	50
2 號晶圓廠	50	50	39
3 號晶圓廠	40	40	40
總估計月產能	146	146	129
產能利用率	94.7%	80.3%	96.1%

- 得益於客戶需求增加，我們的產能利用率從上季度的 80.3% 上升至本季度的 94.7%。

付運晶圓

仟片晶圓	二零一六年 第一季度 (未經審核)	二零一五年 第四季度 (未經審核)	二零一五年 第一季度 (未經審核)	環比	同比
付運晶圓	391	332	351	17.8%	11.4%

- 本季度付運晶圓 391 仟片，環比增長 17.8%，得益於客戶需求增加。

⁶在期末的月產能，且為了比較目的，以 30 天作為計算基礎。

經營開支分析

以千美元計	二零一六年 第一季度 (未經審核)	二零一五年 第四季度 (未經審核)	二零一五年 第一季度 (未經審核)	環比	同比
銷售及分銷費用	1,457	2,215	1,803	(34.2)%	(19.2)%
管理費用 ⁷	21,776	27,753	21,990	(21.5)%	(1.0)%
經營開支	23,233	29,968	23,793	(22.5)%	(2.4)%

- 本季度經營開支 2,320 萬美元，環比下降 22.5%，主要由於上季度計提年終獎金所致。

其他收入淨額分析

以千美元計	二零一六年 第一季度 (未經審核)	二零一五年 第四季度 (未經審核)	二零一五年 第一季度 (未經審核)	環比	同比
租金收入	3,196	3,280	3,191	(2.6)%	0.2%
利息收入	1,310	1,631	1,701	(19.7)%	(23.0)%
匯兌(損失)/收益	(1,563)	1,798	1,140	(186.9)%	(237.1)%
分佔一家聯營公司(損失)/溢利	(452)	(783)	1,208	(42.3)%	(137.4)%
財務費用	(984)	(1,669)	(2,210)	(41.0)%	(55.5)%
政府補貼	203	9,361	242	(97.8)%	(16.1)%
其他	233	626	358	(62.8)%	(34.9)%
其他收入淨額	1,943	14,244	5,630	(86.4)%	(65.5)%

- 本季度其他收入淨額 190 萬美元，環比下降 86.4%，主要由於本季度發生匯兌損失以及獲得的補助較少所致。

⁷管理費用包括確認為研發開支抵消項目的政府補助。

現金流量分析

以千美元計	二零一六年 第一季度 (未經審核)	二零一五年 第四季度 (未經審核)	二零一五年 第一季度 (未經審核)	環比	同比
經營活動所得現金流量淨額	36,056	62,209	33,561	(42.0)%	7.4 %
投資活動所(用)/得現金流量淨額	(2,240)	78,276	(116,647)	(102.9)%	(98.1)%
融資活動所用現金流量淨額	(969)	(63,000)	(2,196)	(98.5)%	(55.9)%
外匯匯率變動影響淨額	2,591	(1,016)	(2,114)	(355.0)%	(222.6)%
現金及現金等價物增加淨額	35,438	76,469	(87,396)	(53.7)%	(140.5)%

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 3,610 萬美元，環比減少 42.0%，主要由於(i)本季度支付年終獎金，(ii)本季度收到的政府補助較少，(iii)本季度支付材料及水電費款項增加所致。
- 本季度投資活動所用現金流量淨額 220 萬美元，其中包括設備投資支出 4,320 萬美元，部分被收回定期存款 4,000 萬美元所抵消。
- 本季度融資活動所用現金流量淨額 100 萬美元，系償還銀行貸款利息支出。

資本結構

以千美元計	於三月三十一日 二零一六年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一五年 (未經審核)
資產總額	1,936,045	1,915,199
負債總額	414,835	424,671
所有者權益總額	1,521,210	1,490,528
資產負債率 ⁸	21.4%	22.2%

資本開支

以千美元計	二零一六年 第一季度 (未經審核)	二零一五年 第四季度 (未經審核)
資本開支	43,159	26,046

- 本季度資本開支 4,320 萬美元，上季度為 2,600 萬美元。

⁸ 資產負債率=為負債總額/資產總額。

流動性分析

以千美元計	於三月三十一日 二零一六年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一五年 (未經審核)
存貨	102,361	107,081
貿易應收款項及應收票據	102,164	103,822
預付款項、按金及其他應收款項	8,904	9,407
應收關聯方款項	35,069	25,282
已抵押存款及定期存款	1,022	41,796
現金及現金等價物	545,879	510,441
流動資產總額	795,399	797,829
貿易應付款項	57,824	66,280
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	77,396	84,676
計息銀行借款	42,750	42,750
政府補助	57,558	57,526
應付關聯方款項	8,710	8,763
應付所得稅	26,288	21,576
流動負債總額	270,526	281,571
淨營運資金	524,873	516,258
速動比率	2.6x	2.5x
流動比率	2.9x	2.8x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	62	80
存貨周轉天數	81	88

- 應收關聯方款項由上季度末的 2,530 萬美元上升至本季度末的 3,510 萬美元，主要由於來自於關聯方的銷售收入增加所致。
- 已抵押存款及定期存款由上季度末的 4,180 萬美元下降至本季度末的 100 萬美元。
- 貿易應付款項由上季度末的 6,630 萬美元下降至本季度末的 5,780 萬美元，主要由於本季度對供應商付款增加所致。
- 其他應付款項、預收賬款及暫估費用由上季度末的 8,470 萬美元下降至本季度末的 7,740 萬美元，主要由於本季度支付年終獎金，部分被向客戶的預收賬款增加所抵消。
- 應付所得稅由上季度末的 2,160 萬美元上升至本季度末的 2,630 萬美元，主要由於計提本季度所得稅開支所致。
- 本季度末淨營運資金 5.249 億美元，流動比率 2.9；上季度末淨營運資金 5.163 億美元，流動比率 2.8。
- 本季度貿易應收款項及應收票據周轉天數及存貨周轉天數分別為 62 天及 81 天，上季度分別為 80 天和 88 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com

華虹半導體有限公司
簡明綜合損益表
(以千美元計, 除每股盈利和股數外)

	截至以下日期止三個月		
	於三月三十一日 二零一六年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一五年 (未經審核)	於三月三十一日 二零一五年 (未經審核)
銷售收入	164,426	139,402	166,088
銷售成本	(116,397)	(98,290)	(115,364)
毛利	48,029	41,112	50,724
其他收入及收益	4,942	16,696	6,641
銷售及分銷費用	(1,457)	(2,215)	(1,803)
管理費用	(21,776)	(27,753)	(21,990)
其他費用	(1,563)	-	(9)
財務費用	(984)	(1,669)	(2,210)
分佔一家聯營公司(損失)/溢利	(452)	(783)	1,208
稅前溢利	26,739	25,388	32,561
所得稅開支	(4,929)	(4,522)	(7,795)
期內溢利	21,810	20,866	24,766
以下各方應佔利潤:			
母公司擁有人	21,810	20,866	24,766
非控股權益	-	-	-
持有人應佔每股盈利			
基本	0.02	0.02	0.02
攤薄	0.02	0.02	0.02
用於計算每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,033,871,656	1,033,871,656	1,033,871,656
用於計算每股攤薄盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,034,276,656	1,037,337,663	1,033,871,656

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至		
	於三月三十一日 二零一六年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一五年 (未經審核)	於三月三十一日 二零一五年 (未經審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	651,898	630,606	558,894
投資物業	181,447	180,484	190,809
預付土地租賃款項	22,060	22,120	23,923
無形資產	8,146	10,735	13,606
於聯營公司的投資	40,582	40,713	43,079
可供出售投資	218,303	217,214	229,641
長期預付款項	12,960	10,806	31,872
遞延稅項資產	5,250	4,692	8,637
非流動資產總額	1,140,646	1,117,370	1,100,461
流動資產			
存貨	102,361	107,081	91,604
貿易應收款項及應收票據	102,164	103,822	111,054
預付款項、按金及其他應收款項	8,904	9,407	8,506
應收關聯方款項	35,069	25,282	43,152
已抵押存款及定期存款	1,022	41,796	92,389
現金及現金等價物	545,879	510,441	559,377
流動資產總額	795,399	797,829	906,082
流動負債			
貿易應付款項	57,824	66,280	58,729
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	77,396	84,676	68,636
計息銀行及其他借款	42,750	42,750	81,543
政府補助	57,558	57,526	65,722
應付關聯方款項	8,710	8,763	21,508
應付所得稅	26,288	21,576	27,529
流動負債總額	270,526	281,571	323,667
流動資產淨額	524,873	516,258	582,415
總資產減流動負債	1,665,519	1,633,628	1,682,876
非流動負債			
計息銀行及其他借款	138,067	137,871	182,875
遞延稅項負債	6,242	5,229	14,568
非流動負債總額	144,309	143,100	197,443
淨資產	1,521,210	1,490,528	1,485,433
權益和負債權益			
股本	1,550,164	1,550,164	1,550,164
儲備	(28,954)	(59,636)	(64,731)
權益總額	1,521,210	1,490,528	1,485,433

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於三月三十一日 二零一六年 (未經審核)	於三月三十一日 二零一六年 (未經審核)	於三月三十一日 二零一六年 (未經審核)
經營活動所得現金流量			
稅前溢利	26,739	25,388	32,561
折舊及攤銷	19,917	19,247	19,844
應佔聯營公司溢利	452	783	(1,208)
營運資金的變動及其它	(11,052)	16,791	(17,636)
經營活動所得現金流量淨額	36,056	62,209	33,561
投資活動所(用)/得現金流量:			
購買物業、廠房及設備項目	(43,159)	(26,046)	(34,764)
其他投資活動所得(用)的現金流量	40,919	104,322	(81,883)
投資活動所(用)/得現金流量淨額	(2,240)	78,276	(116,647)
融資活動所用現金流量:			
新增銀行貸款	-	38,961	-
償還銀行貸款	-	(100,226)	-
已付利息	(969)	(1,735)	(2,196)
融資活動所用現金流量淨額	(969)	(63,000)	(2,196)
現金及現金等價物減少淨額	32,847	77,485	(85,282)
外匯匯率變動影響淨額	2,591	(1,016)	(2,114)
期初現金及現金等價物	510,441	433,972	646,773
期末現金及現金等價物	545,879	510,441	559,377

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張素心(董事長)
王煜(總裁)

非執行董事

陳劍波
馬玉川
森田隆之
葉峻

獨立非執行董事

張祖同
王桂壩太平紳士
葉龍蜚

承董事會命
華虹半導體有限公司
張素心
董事長兼執行董事

中國 香港
二零一六年五月十一日